## IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OF

Application No.:

Group:

Filed:

June 18, 2001

Examiner:

For:

IMAGE PICKUP APPARATUS

#### LETTER

Assistant Commissioner for Patents Box Patent Application Washington, D.C. 20231

Applicant(s): KUNO, Tetsuya et al.

June 18, 2001 1190-0501P

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

Country

Application No.

Filed

JAPAN

2001-050021

02/26/01

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

MACHAEL K. MUTTER

Reg. No. 29,680

P/. O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment (703) 205-8000 /cqc

# KUNO etal 1190-0501P 许 片June 18,200/ B PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed h this Office.

願年月日 te of Application:

2001年 2月26日

olication Number:

特願2001-050021

随 人 cant (s):

三菱電機株式会社

# CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2001年 3月16日

特許庁長官 Commissioner. Patent Office



## 特2001-050021

【書類名】

【整理番号】 530063JP01

【提出日】 平成13年 2月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 27/14

H04N 5/535

特許願

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】 杉浦 博明

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】 三宅 博之

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100083840

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 実

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007205

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する第1の表面と第2の表面を有するとともに前記第1の表面内の一部に撮像面を有する撮像素子と、被写体からの光像を前記撮像素子の撮像面で結像させるための光学系と、前記光学系と前記撮像素子とに係合する支持手段とを有し、前記支持手段は前記光学系が当接する第1の当接部と前記撮像素子が当接する第2の当接部とを有し、前記光学系は前記第1の当接部に直接当接するように固定され、前記撮像素子は、前記第1の表面が前記第2の当接部に直接当接するように固定されることを特徴とする撮像装置。

【請求項2】 前記撮像装置は光学系保持部材を更に含み、前記光学系が前記光学系保持部材と前記支持手段との間に挟持されて固定されるように、前記光学保持部材が前記光学系と前記支持手段とに係合することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。

【請求項3】 前記撮像装置は前記撮像素子に電気的に接続される基板を更に含み、前記基板は前記撮像面が露出する開口部を有するとともに前記支持手段に固定されることを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。

【請求項4】 前記撮像面を除く前記第1の表面が前記第2の当接部に当接する請求項1に記載の撮像装置。

【請求項5】 前記第2の当接部は凸部であり、前記凸部が前記開口部を通って、前記撮像面を除く前記撮像素子の前記第1の表面に当接することを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。

【請求項6】 前記撮像装置は撮像素子保持手段を更に含み、前記撮像素子が前記撮像素子保持手段と前記支持手段との間に挟持されるように、前記撮像保持手段が前記第2の表面と前記支持手段とに係合することを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。

【請求項7】 前記支持手段と前記基板及び前記撮像素子保持手段は接着材により互いに固定され、前記接着材が、前記第2の当接部と前記第2の当接部に 当接する前記第1の面とを除く部分に塗布されることを特徴とする請求項3に記 載の撮像装置。

【請求項8】 前記接着材が紫外線硬化型の接着材であることを特徴とする 請求項7記載の撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学系の合焦調整機構を必要としない撮像装置の構成に関する。

[0002]

【従来の技術】

図7は従来の小型撮像装置の構成を示す。図7において、20はレンズ、21は前記レンズ20を保持するレンズバレル、21aはネジ部、22は後絞り手段、23はレンズバレルを保持するレンズホルダ、23aはネジ部、24は赤外線カットフィルタ、25は撮像素子、25aは撮像素子25における有効画素領域、25bはボンディングワイヤ、25cはリード、26は基板である。

[0003]

このような従来の撮像装置を組み立てる際に生じる合焦性能のばらつきについて以下に述べる。どのくらい正確に焦点が合うかは、図7の乙方向におけるレンズ20と撮像素子25との間の距離の誤差により決まる。合焦性能のばらつきの原因には以下のようなものがある。すなわち、レンズ20とレンズバレル21との間の取り付け誤差、レンズ20の寸法のばらつきによるバックフォーカス(像点距離、以後Bfと称する)のばらつき、レンズバレル21の寸法のばらつき、赤外線カットフィルタ24の厚みのばらつき、レンズホルダ23の寸法のばらつき、乙方向における有効画素領域25aの位置のばらつき、撮像素子25と基板26との取り付け位置のばらつきなどである。

[0004]

図7において、ネジ部21aとネジ部23aを介して、レンズバレル21とレンズホルダ23とを嵌合させる。レンズバレル21をレンズホルダ23に対して回転させると、レンズバレル21をレンズホルダ23に対して乙方向に移動させることができる。これにより、レンズ20と有効画素領域25aとの間の距離を

調節して、光学系を正確に合焦させることで、上記の種々の寸法誤差による合焦性能のばらつきを吸収する。このような従来技術による撮像装置では部品点数が多い。また、量産時には、レンズバレル21をレンズホルダに23に取り付けた後、一台ずつ個別に焦点の調整(以後焦点調整と呼ぶ)をしなければならないという問題があった。

# [0005]

図8は、別の従来技術による撮像装置(特開平9-232548)の一例を示す。この撮像装置では、各構成部材の取り付け精度を上げることで焦点調整の作業をしなくてすむようにしている。図8において、30は絞り板、30aは入射孔(絞り孔)、31は赤外線フィルタ、32は支持部材、32aは絞り板用の位置決め部、32bはレンズ用の位置決め部、32cは撮像素子用の位置決め部、33はレンズ、35は撮像素子、35aは有効画素領域、35bはボンディングワイヤ、36はリード、37は接着材である。

# [0006]

また、光学部材の支持部材32とリード36とを一体成形で製作する必要がある。支持部材36はアクリル、PC(ポリカーボネイド)、ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、合成樹脂などで形成することが多い。また、リード36は導電性の高い金属で形成する必要がある。しかし、支持部材32とリード36のように物理的特性が著しく異なる部材を一体成形することは技術的に難しい。したがって、図9に示すように、支持部材をリード36より下側の部分と上側の部分とを分けて成形することが多い。

## [0007]

各構成部材を正確な位置に取り付けるために、支持部材32には、各構成部材の取り付け位置を形成している。すなわち、レンズ33の位置決め部32bを設けることでレンズ33の取り付け精度を高め、撮像素子35の取り付け部32cを設けることで撮像素子35の取り付け精度を高めている。また、接着材37を注入する部分を凹部とすることで、接着材37によって撮像素子35が持ち上げられることがないようにしている。また、各構成部材の取り付け精度を高めるこ

とで、レンズ33の焦点を調整するための機構をなくすとともに、図7に示した レンズバレル21とレンズホルダ23とに相当する部分を支持部材32として一 体化し、構成部材数の低減をも図っている。

[0008]

図9は、上記のように構成された撮像装置の合焦性能に影響を及ぼす組立誤差 の要因を示す。前述のように、支持部材32とリード36のように物理的特性が 著しく異なる部材を一体成形することは技術的に難しい。したがって、ここでは 、支持部材を、リード36より下側の部分と上側の部分とに分けて構成した場合 について説明する。まず、レンズ33の曲率半径等の誤差から生じるBf誤差が あり、この誤差を△Aにて表す。撮像装置の小型化を図る場合、撮像素子35を セラミックパーケージなどに入れず、半導体のウェハをそのまま用いる。そこで 、撮像素子35のウェハの厚みの誤差をACとし、支持部材32の寸法の誤差を  $\Delta$  Dとし、撮像素子 3 5 と取り付け部 3 2 c との間の隙間の誤差を  $\Delta$  E とし、レ ンズ33と支持部材32との接着材の層の厚さを AFとする。また、凹部に入る 接着材37の量が少なくて、撮像素子35が取り付け部32cより浮くことがな ければ、誤差△Eは、○とすることができる。支持部材32の上側部分と下側部 分を接着する際に、上側部分と下側部分との接合部には、接着材の層39の誤差 ΔGを生じる。上記の誤差はすべて合焦性能に影響を及ぼす。 焦点調整を必要と しない上記構成による撮像装置を実現するためには、いま合焦性能として許容さ れる焦点深度を $\Delta$   $\delta$  とした場合、前記誤差の合計 $\Delta$  T =  $\Delta$  A +  $\Delta$  C +  $\Delta$  D +  $\Delta$  F+ΔGをΔδより小さくする必要がある。したがって、上記ばらつきΔΑ、ΔC 、AD、AF及びAGを正確に管理する必要があり、各部材の寸法管理や組み立 てに高い精度を要するという問題があった。

[0009]

図10は、特開平9-121041に開示された他の従来例を示し、これは焦点調整を必要としないように構成されている。40はレンズ、41はレンズ取り付け部材、42は脚、43は位置決め用傾斜面、44は撮像素子、45は紫外線硬化樹脂(以後、UV硬化樹脂と称す)、46は基板である。本撮像装置では、被写体からの光像を集光するレンズ40と、レンズ40を取り付けて支持する部

分(レンズ取付部材 4 1)とを一体化させ、レンズ 4 0 の合焦方向への取付誤差 の低減を図っている。また、位置決め用傾斜面 4 3 を用いて、レンズ 4 0 の光軸 を撮像素子 4 4 の有効画素領域の中心と一致させているが、図 1 1 に示すように 位置決め用傾斜面が傾斜しているので、レンズ 4 0 の光軸と撮像素子 1 の法線が ずれる、いわゆる「θ ずれ」の問題が生じ易い。そのためレンズ部材の取付作業 には、微調整機構を有する取付装置を必要とする。

[0010]

さらに、図10及び図11に示した従来の撮像装置では、光学系におけるレンズ40とそれを支持する機構部(レンズ取付部材41および脚42)との間の取付誤差を無くすために、それら部材を一体化している。しかし、一体化のためには各部材40、41、42、43を一体成形する必要がある。さらに、光を集光するためのレンズ40だけを透明とし、他の部分を遮光しなければ光ノイズが発生する。したがって、一体成形した後に、レンズ40以外の部分を黒色に塗装する後工程を必要とする。

[0011]

また、レンズ40の部分には透明な材料(例えばアクリル(PMMA))を用い、他の部分には黒色の材料を用いて、2色成形を行うことで製作できるが、レンズ40のように、その曲率半径に精度を要する光学部材を2色成形で製作することは、技術的にきわめて困難であり、高い量産技術を要するという問題がある

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

従来の撮像装置は、以上のように構成されていたので、量産時には、撮像装置 を組み立てる際に、個別に、焦点調整を行う必要があり、量産効率が低いという 問題があった。

[0013]

また、焦点調整を行うので、撮像装置の構成部材が多くなるという問題があった。

[0014]

更に、焦点の無調整化を図るためには、構成部材の成形精度を上げるとともに 、各部材の組立作業に高い精度を要するという問題があった。

[0015]

更に、正確に合焦させる目的で、光学系のレンズとホルダとを互いに対して正確に位置決めするには、レンズとホルダとの一体成形など、量産技術として困難な製造を行う必要があった。

[0016]

更に、レンズとホルダを一体成形で製作した場合、光学的ノイズの問題を解決 するために、ホルダの部分を遮光するための後工程(例えば、黒色塗料を塗布) を必要としたり、2色成形など量産技術として困難な製造を行う必要があった。

[0017]

更に、撮像素子の下側に基板を配置するので、撮像装置の大きさを決める要素には、光学系から定まる光学的寸法だけでなく基板の厚みも含まれるという問題 点があった。

[0018]

更に、従来の構成では、撮像素子の一部に光学ホルダを接触させる構造の場合 、基板を取り付ける位置を自由に選択できないという問題点があった。

[0019]

本発明は以上のような問題点を解決するためになされたもので、構成部材の点数を減らし、且つ組立誤差を低減し、焦点の無調整化を図った量産性の高い小型の撮像装置を得ることである。

[0020]

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の撮像装置は、対向する第1の表面と第2の表面を有するとと もに前記第1の表面内の一部に撮像面を有する撮像素子と、被写体からの光像を 前記撮像素子の撮像面で結像させるための光学系と、前記光学系と前記撮像素子 とに係合する支持手段とを有する。前記支持手段は前記光学系が当接する第1の 当接部と前記撮像素子が当接する第2の当接部とを有する。前記光学系は前記第 1の当接部に直接当接するように固定され、前記撮像素子は、前記第1の表面が 前記第2の当接部に直接当接するように固定される。

#### [0021]

請求項2に記載の撮像装置は、請求項1に記載の装置において、前記撮像装置は光学系保持部材を更に含む。前記光学系が前記光学系保持部材と前記支持手段との間に挟持されて固定されるように、前記光学保持部材が前記光学系と前記支持手段とに係合する。

## [0022]

請求項3に記載の撮像装置は、請求項2に記載の撮像装置において、前記撮像 装置は前記撮像素子に電気的に接続される基板を更に含み、前記基板は前記撮像 面が露出する開口部を有するとともに前記支持手段に固定される。

#### [0023]

請求項4に記載の撮像装置は、請求項1に記載の撮像装置において、前記撮像 面を除く前記第1の表面が前記支持手段に対して当接する。

# [0024]

請求項5に記載の撮像装置は、請求項3に記載の撮像装置において、前記第2 の当接部は凸部であり、この凸部が前記開口部を通って、前記撮像面を除く前記 撮像素子の前記第1の表面に当接する。

## [0025]

請求項6に記載の撮像装置は、請求項3に記載の撮像装置において、前記撮像 装置が撮像素子保持手段を更に含み、前記撮像素子が前記撮像素子保持手段と前 記支持手段との間に挟持されるように、前記撮像素子保持手段が前記第2の表面 と前記支持手段とに係合する。

## [0026]

請求項7に記載の撮像装置は、請求項3に記載の撮像装置において、前記支持 手段と前記基板及び前記撮像素子保持手段は接着材により互いに固定され、前記 接着材が、前記第2の当接部と前記第2の当接部に当接する前記第1の面とを除 く部分に塗布される。

# [0027]

請求項8に記載の撮像装置は、請求項7記載の撮像装置において、前記接着材

が紫外線硬化型の接着材である。

[0028]

【発明の実施の形態】

実施の形態1.

図1は、本発明による撮像装置の構成を示す。図1において、1は固体デバイスであるCCD(Charge Coupled Device)センサやCMOS(Complimentary Metal Oxide Semi-conductor)センサ等の撮像素子、1aは撮像素子内にて光電変換を行う有効画素領域、2は基板、3は光学系、4は前記光学系3を支持するホルダ、5はホルダ4に対して光学系3を固定するバレル、6は前記撮像素子1をホルダ4に対して固定するセンサ支持板、7は赤外線カットフィルタである。

[0029]

図2(a)と図2(b)は、図1に示した撮像装置の光学系3、ホルダ4及びバレル5の外部形状を示す。図2(c)と図2(d)は、内部形状を示す。図2(c)は、図1に示した構成図に対応する。

[0030]

図1において、撮像素子1はベアチップ(半導体ウェハから切り出したもので、パッケージを有しない)であり、その上面に、光学系3によって結像した被写体の光像を電気信号として変換する有効画素領域1 a と、撮像素子1以外の回路と電気的に結合するための電極1 b とを有する。図3 (a) は撮像素子1と基板2との接合部の拡大図である。図3 (b) は、図3 (a) の矢印C方向からみた図である。小型で薄型の撮像装置を構成しようとする場合は、薄膜のフレキシブル基板(FPC:Flexible Printed Circuit board)を用いて、薄型の基板2を実現する。例えばポリイミド基板を用いることにより50μm~80μm程度の厚みの基板が実現できる。本発明では基板の種類、材質は特に問わない。基板2は、開口部2aを有しており、その開口部2a内に撮像素子1の有効画素領域1aが露出するように、撮像素子1と基板2とが接合されている。基板2上に配線された回路線2bが、撮像素子1内に形成した回路の出力端子である端子部1bに対して、銅バンプを介して接合される(CO

F: Chip On FPC)。これにより、基板2と撮像素子1との間の電気的な接続がなされる。有効画素領域1 a は基板2の開口部2 a を介して光学系3からの光像を受光する。

## [0031]

光学系3は、被写体からの光を集光して、撮像素子1の有効画素領域1a内で結像させるレンズ3aと、前記レンズ3aを他の部材に固定するのに必要な鍔3bとから構成されている。レンズ3aと鍔3bとは、光学系3を作成する際に一つの部品として同一部材で成形されている。ホルダ4は前記光学系3、赤外線カットフィルタ7及び撮像素子1を支持する手段である。また、ホルダ4は、被写体像以外の光を遮光するための役割も果たしており、外光を遮断する目的で、光を通さない黒色の材料、例えば、ポリカーボネイド(PC)などで製作される。バレル5は、ホルダ4上に配置した光学系3を上から保持するための手段であり、ホルダ4と同様に光を通さない黒色の材料にて製作される。赤外線カットフィルタ7は、撮像素子1の分光感度特性と人間の比視感度特性(spectralluminous efficiency)を合わせるための感度補正フィルタである。通常は色ガラスや、透明ガラス上に色フィルタを蒸着することで実現している。センサ支持板6は、ホルダ4に対して撮像素子1を保持及び固定するための板である。

#### [0032]

図4は、図1に示した撮像装置を構成している各手段を示す分解図である。光学系3は光学性能に影響を与えない鍔3bをホルダ4の接触面4cに対して接触させる。光学系3を基準として考えた場合、合焦性能に関する距離であるフランジバックの基準位置は、光学系3の鍔3bの接触面3cとなり、接触面3cから有効画素1bまでの距離がフランジバックとなる。上記鍔3bは接触面3cを平面にて形成することができ、その部分をホルダ4の接触面4cに押し当てることで容易にホルダ4に取り付けることができ、また取り付け誤差が生じない。

### [0033]

ホルダ4側にも、光学系3との接触面4cを設け、光学系3の接触面3cとホルダ4の接触面4cとの接合部分には、どんな部材も介在させず、直接それぞれ

の接触面を互いに当接させる。したがって、ホルダ4と光学系3は、単に接合しているだけであり、接着等による固定はされていない。

[0034]

バレル5は、ホルダ4上に配置された光学系3に対して上から覆い被さるように取り付けられ、バレル5の部位5aと5b(図4)にて、ホルダ4に固定される。部位5aに塗布された接着部材(黒帯で示す部分)により、バレル5と光学系3とを接着する。また、部位5bに塗布された接着部材により、バレル5とホルダ4とを接着する。光学系3とホルダ4は、それぞれの接触面3cと接触面4cが互いに接触した状態で固定される。また、ホルダ4には、接着の際、余剰分の接着材が逃げていくように逃げ溝4dを設けている。さらに、バレル5は開口部(アパーチャ)5cを有し、前記開口部5cを通して、撮像に必要な被写体の光像を入射させ、光学的絞りの役割を果たす。

[0035]

また、上記部位5aと5bに塗布する接着材は、光学系3やホルダ4側に塗布してもよい。この場合、光学系3の接触面3cとホルダ4の接触面4cとの間に接着材が入り込まないような位置に接着材を塗布すれば同じ効果が得られる。

[0036]

光学系3、バレル5及びホルダ4を上記のように構成することにより、図10に示した従来例のような、量産には不向きな、若しくは、高い量産技術を必要とする一体成形や2色成形などを行わずに、合焦性能に影響する取付誤差を生じない構成を実現できる。また、光学系3の光軸が、撮像素子1の撮像領域である有効画素領域1aの中心点を通過するように、光学系3を位置決め(図4のXY方向。Yは紙面に対して垂直な方向)するためには、例えば、バレル5の内側の形状や寸法、光学系3の外周寸法(鍔3a部)およびホルダー5のバレル5との接触面の寸法を互いに整合させておけば、光軸を合わせる作業を特に必要としない。また、図11に示した従来技術において生じやすいθずれの問題も生じない。

[0037]

赤外線カットフィルタ7は、ホルダー5に対して接着材で接着される。赤外線 カットフィルタ7の乙方向の位置精度は合焦性能に影響しないのでその説明は略 す。

## [0038]

図5は撮像素子1を取り付ける方向から見たホルダ4示す。ホルダ4は、撮像素子1を支持する手段となる2つの凸部4aを有している。前記凸部4aが基板2の開口部2aを通って、有効画素領域1aを除く撮像素子1上の領域に接触する。凸部4aと撮像素子1との接触面には、接着材等どんな部材も介在させない。上記のように撮像素子1を支持する手段を凸形状(4a)とすることで、基板3を介さず撮像素子1に直接接触させることが可能となり、基板3の厚みのばらつきに関係なく、合焦性能を左右する部品の位置決めを行うことができる。上記の構造により、撮像素子1の有効画素領域1aの側に配置された基板が、凸部4aよりも光学系3に近づく。したがって、基板の厚みは、撮像装置の光軸方向の寸法に影響しないから、撮像装置の小型化を図る場合に有利となる。

#### [0039]

センサ支持板 6 は、ホルダ 4 の下部に配置された撮像素子 1 および基板 2 を下から固定するために取り付けられる。センサ支持板 6 の周囲(図 1 の 4 b)に塗布された接着材により、撮像素子 1、ホルダ 4 及びセンサ支持板 6 を互いに接着させる。また、基板 2 とホルダ 4 間の部位に塗布された接着材により、基板 2 とホルダ 4 とを接着する。センサ支持板 6 が、ホルダ 4 と撮像素子 1 とに、接着されて固定することにより、前記撮像素子 1 はその上部をホルダの凸部 4 a に押し当てられたまま固定される。

#### [0040]

図6は、合焦性能に影響を及ぼす種々の誤差を示す。成形時に生じる光学系2の寸法の誤差に起因するBfの誤差を ΔAとする。光学系3とホルダ4との間は、従来技術のような接着材で接合せず、当接させているだけなので、従来技術のように接着材の厚みによる Z 軸方向の取付誤差は生じない。また、ホルダ4と撮像素子1の上面とを当接させているだけで接着材を使用しないので、従来技術のような接着材の厚みによる Z 軸方向の取り付けの誤差は生じない。

## [0041]

赤外線カットフィルタ7は、レンズ部3aから撮像素子1の有効画素領域1a

までの間のどの位置に設けても、光学的に結像条件に影響を与えないので、赤外線カットフィルタ7の取付誤差は合焦性能に影響を与えない。したがって、赤外線カットフィルタ7の厚みのばらつきのみが合焦性能に影響を与えることになる。赤外線カットフィルタ7の厚みの誤差を、赤外線カットフィルタ7の屈折率を考慮して空気換算したときの値をΔBとする。

# [0042]

次に、撮像素子1の厚みのばらつき(撮像素子1底面から有効画素領域1 a までの高さ)を $\Delta$ Cとする。ホルダ4の当接面4 c(又はレンズの接触面3 c)から、凸部4 a が撮像素子に当接する面までのホルダの寸法の誤差を $\Delta$ Dとする。本構成では、撮像素子1の上面側にホルダ4を押し当てているので、B f はレンズ部3 a から有効画素 1 a 領域までの距離で決まり、撮像素子1の厚みの誤差  $\Delta$ Cおよび基板2の厚みの誤差は、合焦性能に関する誤差として加算されない。したがって、合焦性能に影響を与える誤差は( $\Delta$ A+ $\Delta$ B+ $\Delta$ D)となり、( $\Delta$ A+ $\Delta$ B+ $\Delta$ D)の値が光学系2の焦点深度 $\Delta$ 8より小さければ焦点調整をする必要がない。

# [0043]

上述した個々の誤差について述べる。小型で且つ薄型の撮像装置を構成する目的で、例えば、光学系3の画角を標準的な $50\sim55$ 度に選び、撮像素子1の有効画素領域1aの大きさを $1/5\sim1/7$ インチの光学系サイズとすると、そのレンズの厚みは数mm程度となる。したがって、光学系3の寸法の誤差から、 $\Delta$  Aは $\pm10\sim20\mu$ m程度であると想定される。また、Bfは上記光学系3の場合は、 $2\sim4$ mm程度であり、光学系3から撮像素子1上面までのホルダ4の寸法は上記Bfにほぼ等しい。同様に、ホルダ4の寸法の誤差は $\pm10\sim20\mu$ mが想定される。金型などを使って射出成形する際に、上記寸法誤差には、射出成形材料の線膨張係数のばらつきなどが含まれる。赤外線カットフィルタ7の厚みを0.55mmとして厚みばらつきを $\pm20\mu$ mと予測する。赤外線カットフィルタ7は、ガラスで製作されることが多い。ガラスの屈折率は1.5である。よって誤差1.50であ

[0044]

例えば、数値の一例を示すと、誤差の最大値は下記のようになる。

 $\Delta A + \Delta B + \Delta D = \pm 2.0 \pm 6.7 \pm 2.0 = \pm 4.6.7 \mu \text{ m}$ 

一方、本撮像装置の焦点深度の概算は、光学系のF値(明るさ)と最小錯乱円の大きさによって算出できる。撮像素子1の場合、最小錯乱円は、画素の大きさに置き換えることができる。したがって、いま、F値を2.8、撮像素子1の画素の大きさを20μmとすると、焦点深度=±2.8×20μm=±56μmとなる。この計算による焦点深度は、撮像装置の合焦に寄与する最大誤差±46.7μmよりも大きいので、充分に合焦した画像を撮像することが可能である。上記数値は一例であり、F値、画素の大きさ、光学系の画角や撮像素子の大きさは上記に限るものではない。

[0045]

図6 (b) は、図8に示す従来の撮像装置に、本発明と同様の赤外線カットフィルタ34を設けた場合の合焦誤差の要因を示す。従来技術では、また、リードと支持部材32との一体成形が困難である場合に生じる、支持部32と基板8との接着材の厚みの誤差ΔGを加味すればさらに全体の誤差は大きくなる。例えば、レンズ33のBfの誤差ΔAを±10~20μm、支持部材32の寸法誤差ΔDを±10~20μmと仮定する。また、凹部に入る接着材の量が少なくて、撮像素子1が取り付け部32cより浮くことがなければ、誤差ΔEは、ゼロとすることができる。基板面をホルダに当接することで、撮像素子1を位置決めするので、撮像素子1の厚み400μmに対して、その厚み誤差ΔC=±30μmが生じる。レンズ33と支持部材32との接着材の層の誤差ΔFは数μm以下である。いまΔFを4μmと仮定すると、合焦誤差の最大値は下記のようになる。

 $\Delta A + \Delta B + \Delta C + \Delta D + \Delta F$ 

 $=\pm 2.0 \pm 6.7 \pm 3.0 \pm 2.0 \pm 4 \mu m$ 

 $= \pm 80.7 \mu \text{ m}$ 

[0046]

本実施の形態による撮像装置はレンズ33と支持部材32との間の接着材による誤差ΔFが生じない。さらに、撮像素子1は、フリップチップ実装されているので有効画素領域1aが形成される面が、撮像素子1の取付の基準となる。した

がって、撮像素子1の厚みの誤差 Δ C は、合焦性能として影響を与える誤差に加算されない。よって、本実施の形態に示す撮像装置による構成では、合焦性能に影響を与える誤差が大幅に小さくなり、合焦調整をするための手段を必要としなくなる。また、従来の構成よりも緩やかな組立精度で、合焦調整を実現できる。

#### [0047]

また、撮像素子1、ホルダ4及びセンサ支持板6を互いに固定する接着材として、紫外線によって硬化するUV硬化材を用いてもよい。UV硬化材は低温にて高速で硬化するので、組立作業中に上記各部材間の位置ずれが生じにくい。また、UV硬化時に接着材自体の収縮が小さいので、さらに上記各部材間の位置ずれが生じにくい。また、熱収縮が小さく、耐熱性が大きいので、熱の影響を受けにくい撮像装置を得ることができる。UV硬化材は、図1の4bに示す個所に塗布し、その後UV照射を行うことで硬化し、各部材を相互に固定することができる

## [0048]

上記のように撮像装置を構成することによって、焦点調整を行う機構が不要となるので、構成する部品点数を少なくすることができる。

#### [0049]

また、本発明では光学系2 a のレンズ形状は両凸レンズであるが、レンズ形状を凹と凸との組み合わせで構成しても問題ない。

#### [0050]

本発明では、保持手段であるバレル5を、光学系3とホルダ4とに接着することで、光学系3とホルダ4とを固定した。しかし、接着材を用いずに、バレル5、ホルダ4及び光学系3の間の寸法をよく整合させて、バレル5をホルダ4に圧入させることにより嵌合させてもよい。

## [0051]

## 【発明の効果】

本発明の撮像装置は、以下のような効果を奏する。請求項1に記載の撮像装置は、対向する第1の表面と第2の表面を有するとともに前記第1の表面内の一部 に撮像面を有する撮像素子と、被写体からの光像を前記撮像素子の撮像面で結像

1 4

させるための光学系と、前記光学系と前記撮像素子とに係合する支持手段とを有する。前記支持手段は前記光学系が当接する第1の当接部と前記撮像素子が当接する第2の当接部とを有する。前記光学系は前記第1の当接部に直接当接するように固定され、前記撮像素子は、前記第1の表面が前記第2の当接部に直接当接するように固定される。したがって、合焦精度に起因する誤差要因を削減し、焦点の無調整化を実現できる。組み立て時に焦点調整を行う必要が無いので、量産効率をあげることができる。さらには焦点調整に必要な機構部を不要なので、構成部品の低減化を行うことができる。

## [0052]

請求項2に記載の撮像装置は、請求項1に記載の装置において、前記撮像装置は光学系保持部材を更に含む。前記光学系が前記光学系保持部材と前記支持手段との間に挟持されて固定されるように、前記光学保持部材が前記光学系と前記支持手段とに係合する。したがって、簡単な構成でレンズをホルダーに固定保持することができるるとともに焦点の無調整化を図ることができる。

# [0053]

請求項3に記載の撮像装置は、請求項2に記載の撮像装置において、前記撮像装置は前記撮像素子に電気的に接続される基板を更に含み、前記基板は前記撮像面が露出する開口部を有するとともに前記支持手段に固定される。したがって、支持手段を撮像素子に直接接触させて位置決めすることが可能となる。基板の厚みばらつきに関係なく、合焦性能に関する寸法の位置決めを行うことができ、かつ従来の撮像装置の構成に比べ基板の厚み分の高さを削減することで撮像装置の小型化が図れる。

#### [0054]

請求項4に記載の撮像装置は、請求項1に記載の撮像装置において、前記撮像面を除く前記第1の表面が前記支持手段に対して当接する。したがって、撮像素子の厚みのばらつきが合焦性能に寄与しない。

## [0055]

請求項5に記載の撮像装置は、請求項3に記載の撮像装置において、前記第2 の当接部は凸部であり、この凸部が前記開口部を通って、前記撮像面を除く前記 撮像素子の前記第1の表面に当接する。したがって、撮像素子を支持する手段を 簡単な凸形状とすることで、基板を介さず、撮像素子に支持手段を接触させるこ とができる。これにより、基板の厚みのばらつきに関係なく、合焦性能に関する 寸法の位置決めを行うことができる。

[0056]

請求項6に記載の撮像装置は、請求項3に記載の撮像装置において、前記撮像 装置が撮像素子保持手段を更に含み、前記撮像素子が前記撮像素子保持手段と前 記支持手段との間に挟持されるように、前記撮像素子保持手段が前記第2の表面 と前記支持手段とに係合する。したがって、簡単な構成で撮像素子をホルダーに 固定保持することができる。

[0057]

請求項7に記載の撮像装置は、請求項3に記載の撮像装置において、前記支持 手段と前記基板及び前記撮像素子保持手段は接着材により互いに固定され、前記 接着材が、前記第2の当接部と前記第2の当接部に当接する前記第1の面とを除 く部分に塗布される。したがって、撮像素子とホルダーとを強く固定保持するこ とができる。

[0058]

請求項8に記載の撮像装置は、請求項7記載の撮像装置において、前記接着材が紫外線硬化型の接着材である。したがって、組み立て時に部材間の位置精度を上げることができ、耐熱性が高い接合を実現できる

#### 【図面の簡単な説明】

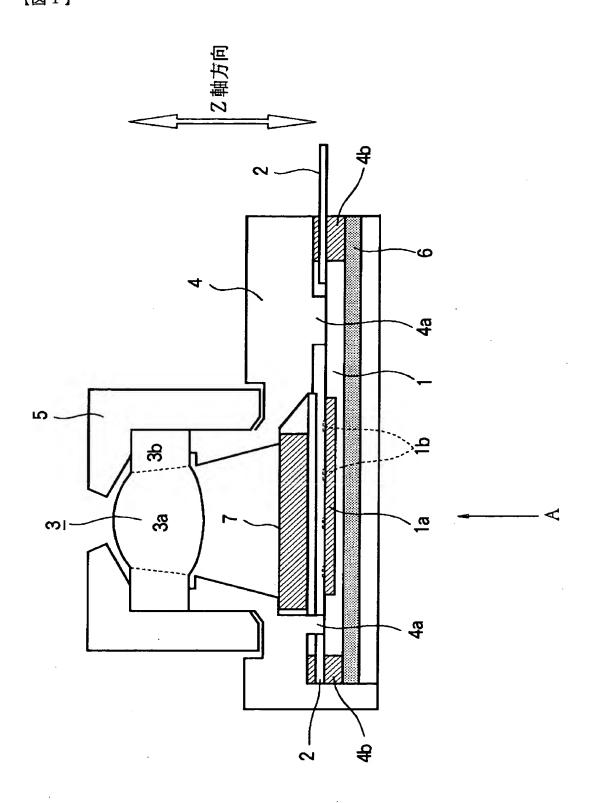
- 【図1】 本発明による撮像装置の構成を示す図である。
- 【図2】 (a)から(d)は、本発明による撮像装置の構成を示す外形図 および内部の構成を示した図であり、(a)は平面図、(c)は(a)の線ccに沿ってみた断面図、(b)は(a)の矢印Bの方向からみた側面図、(d) は、(a)の線d-dに沿ってみた断面図である。
- 【図3】 (a)と(b)は本発明による撮像素子と基板の構成を示し、(a)は側面図、(b)は(a)の矢印Cの方向からみた平面図である。
  - 【図4】 本発明の撮像装置の分解側面断面図である。

- 【図5】 撮像素子を取り付ける方向からみたホルダを示す図である。
- 【図6】 (a)と(b)は合焦性能に影響を及ぼす撮像装置の誤差要因を示し、(a)は本発明の例を示し、(b)は図8の従来技術の構成に本発明の赤外線フィルタを設けた場合を示す。
  - 【図7】 従来技術による撮像装置の構成を示した図である。
  - 【図8】 従来技術による撮像装置の他の構成を示した図である。
- 【図9】 図8に示した撮像装置の合焦性能に影響する各部の寸法誤差を示した図である。
  - 【図10】 従来技術による撮像装置の更に他の構成を示す。
  - 【図11】 図10に示す撮像装置の取付誤差を示す。

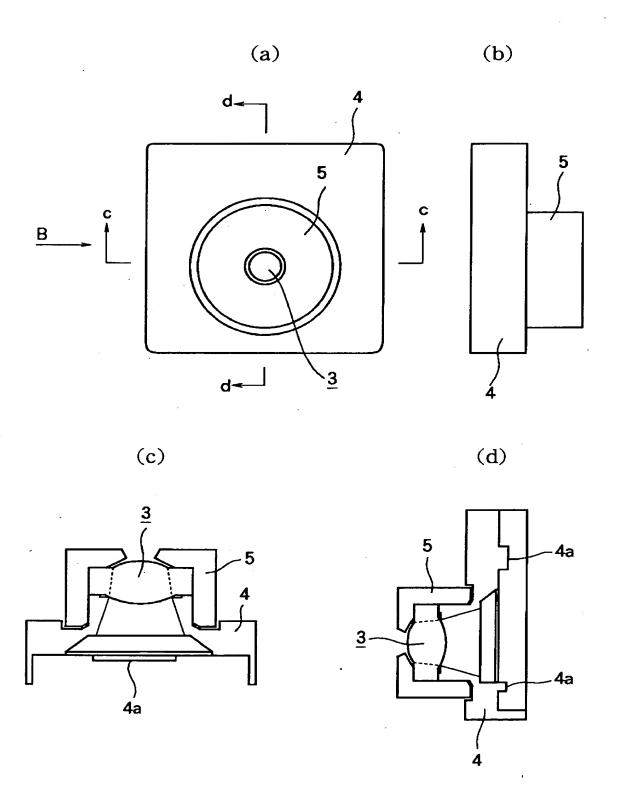
# 【符号の説明】

1 撮像素子、 1 a 有効画素領域、 1 b 端子部、 2 基板、 2 a 開口部、 2 b 回路線(リード)、 3 光学系、 3 a レンズ、 3 b 鍔、 3 c 接触面、 4 ホルダ、 4 a 凸部、 4 b UV硬化型接着材、 4 c 接触面、 4 d 逃げ溝、 5 バレル、 5 a 接着部位(光学系との接着)、 5 b 接着部位(ホルダとの接着)、 6 センサー支持板、 7 赤外線カットフィルタ、 2 0 レンズ、 2 1 レンズバレル、 2 1 a ネジ部(レンズバレル)、 2 2 後絞り手段、 2 3 レンズホルダ、 2 3 a ネジ部(レンズホルダ)、 2 3 b 位置決め部、 2 4 赤外線カットフィルタ、 2 5 撮像素子、 2 5 a 有効画素領域、 2 5 b ボンディングワイヤ、 2 5 c リード、 2 6 基板、 3 0 絞り板、 3 0 a 入射孔(絞り孔)、 3 1 フィルタ、 3 2 支持部材、 3 2 a 位置決部(絞り板用)、 3 2 b 位置決部(レンズ用)、 3 2 c 位置決部(撮像素子用)、 3 3 レンズ、 3 4 赤外線カットフィルタ、 3 5 撮像素子、 3 5 a 有効画素領域、 3 5 b ボンディングワイヤ、 3 6 リード、 3 7 接着材、 3 9 接着材の層

【書類名】 図面 【図1】

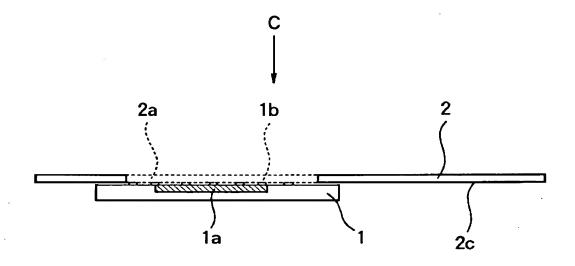


【図2】

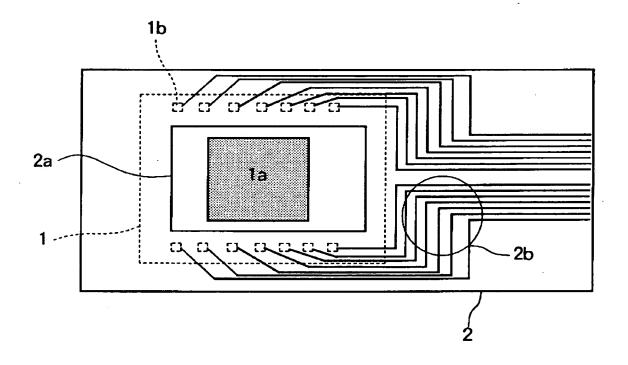


【図3】

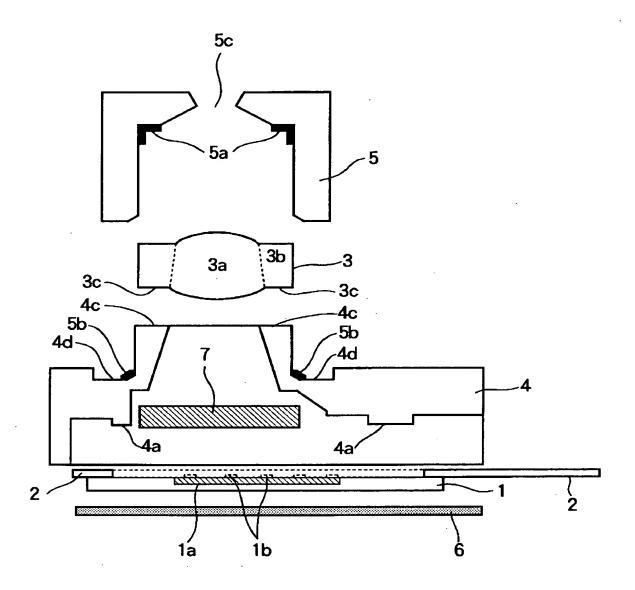
(a)



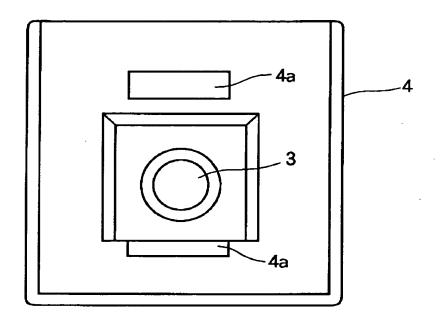
(b)



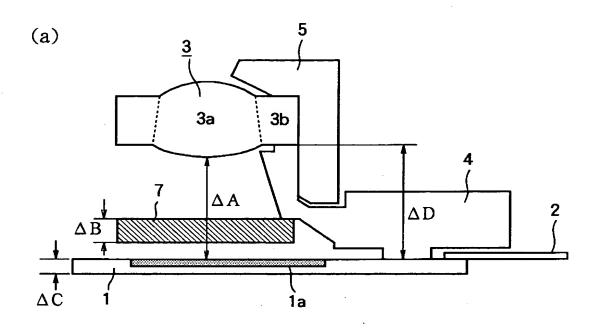
【図4】

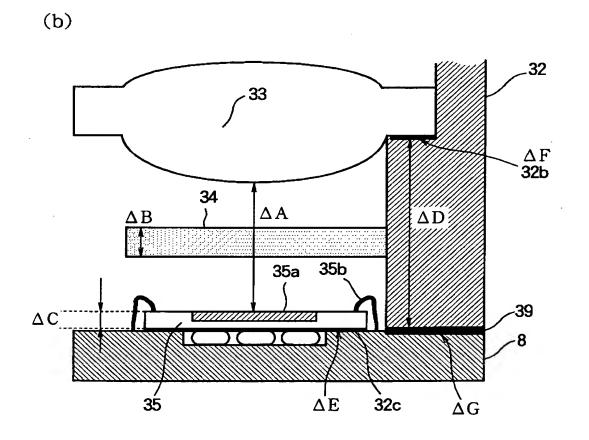


【図5】

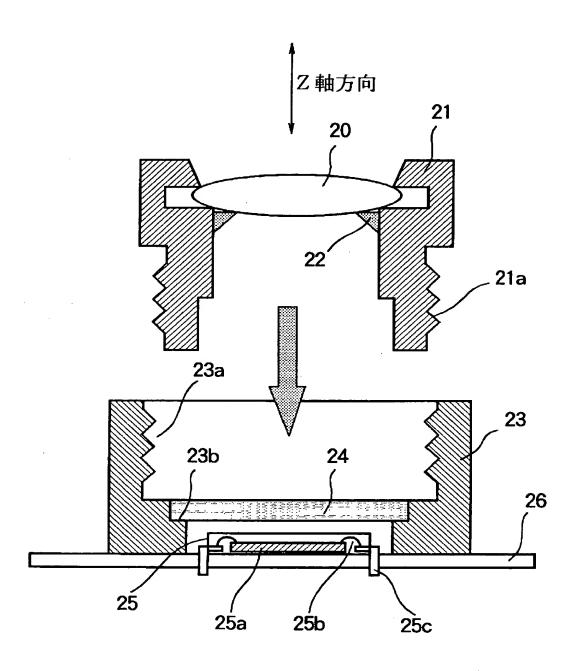


【図6】

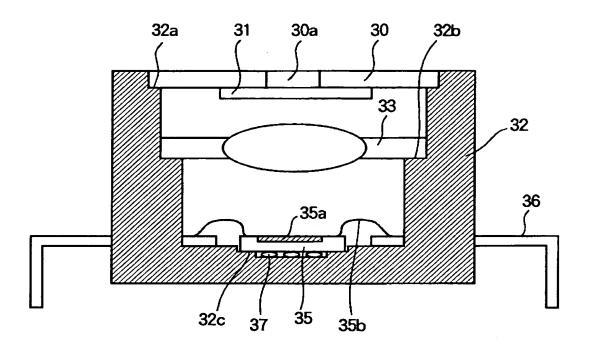




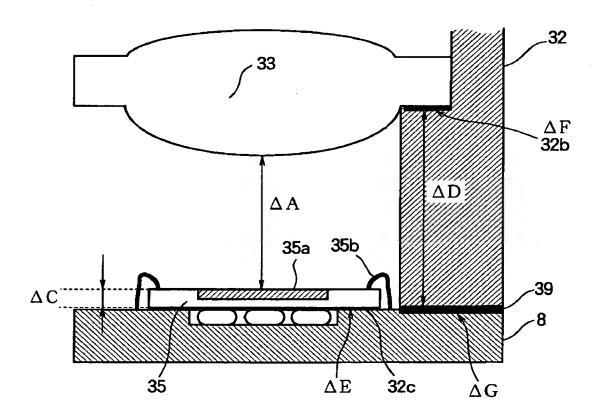
【図7】



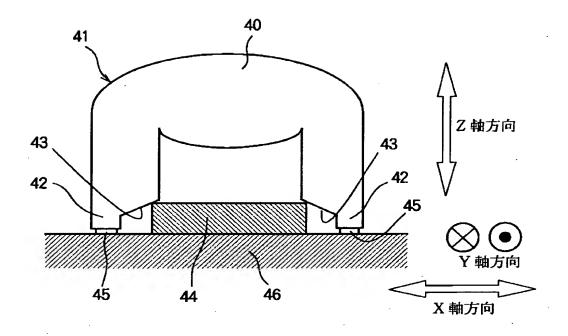
【図8】



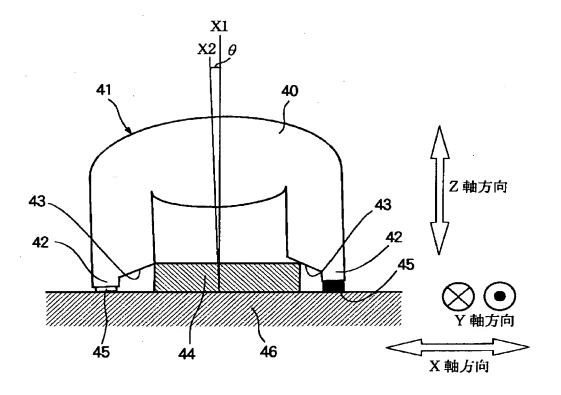
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 焦点を調整する必要がない小型の撮像装置を得る。

【解決手段】 対向する第1の表面と第2の表面を有するとともに前記第1の表面内の一部に撮像面1 a を有する撮像素子1と、被写体からの光像を前記撮像素子の撮像面で結像させるための光学系3と、前記光学系3と前記撮像素子とに係合する支持手段4とを有する。前記支持手段4は前記光学系3が当接する第1の当接部4 c と前記撮像素子1が当接する第2の当接部4 a とを有する。前記光学系3は前記第1の当接部4 c に直接当接するように固定され、前記撮像素子1は、前記第1の表面が前記第2の当接部4 a に直接当接するように固定される。

【選択図】

図 1

# 出願人履歷情報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

氏 名

三菱電機株式会社